



4979

華星光通科技(股)公司
LuxNet Corporation
法人說明會
2025 Investor Conference

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息可能包含對於未來展望的表述，本公司不暗示、不聲明亦不保證其內容之正確性或可靠性，使用者應自行判斷與承擔風險。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。有些資訊可能受未來不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。

除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

本簡報資料中所提供之資訊不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

簡報 大綱

公司簡介

經營實績

技術及製程能力

市場趨勢及未來展望

Q & A

公司簡介

成立日期	2001/11/15
實收資本額	新台幣1,408百萬元
所在地	桃園市中壢區合江路 & 吉林路
員工人數	600人
主要產品及服務	LD & PD/APD . OSA, Optical Engine, ELS, CoC. Transceiver. OEM /ODM & JDM / Foundry Business



資產負債表

單位：新台幣百萬元	2024/9/30		2024/12/31		2025/9/30	
現金及約當現金	2,273	59.1%	3,128	65.9%	3,102	58.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產	-	-	-	-	100	1.9%
應收票據及帳款淨額	364	9.5%	400	8.4%	386	7.2%
存貨	448	11.6%	385	8.1%	565	10.6%
其他流動資產	47	1.2%	58	1.2%	61	1.1%
流動資產	3,132	81.4%	3,971	83.7%	4,214	79.1%
不動產、廠房及設備	608	15.8%	615	13.0%	1,028	19.3%
公允價值衡量之金融資產(FVOCI)	87	2.3%	87	1.8%	67	1.3%
其他非流動資產	22	0.6%	72	1.5%	18	0.3%
非流動資產	717	18.6%	774	16.3%	1,113	20.9%
資產總額	3,849	100.0%	4,745	100.0%	5,327	100.0%
流動負債	678	17.6%	601	12.7%	884	16.6%
非流動負債	-	-	746	15.7%	757	14.2%
負債總額	678	17.6%	1,347	28.4%	1,641	30.8%
普通股股本	1,408	36.6%	1,408	29.7%	1,408	26.4%
資本公積	1,099	28.6%	1,174	24.7%	1,174	22.0%
保留盈餘	723	18.8%	875	18.4%	1,183	22.2%
其他權益	(59)	(1.5%)	(59)	(1.2%)	(79)	(1.5%)
權益總額	3,171	82.4%	3,398	71.6%	3,686	69.2%
每股淨值(元)	22.52		24.13		26.18	

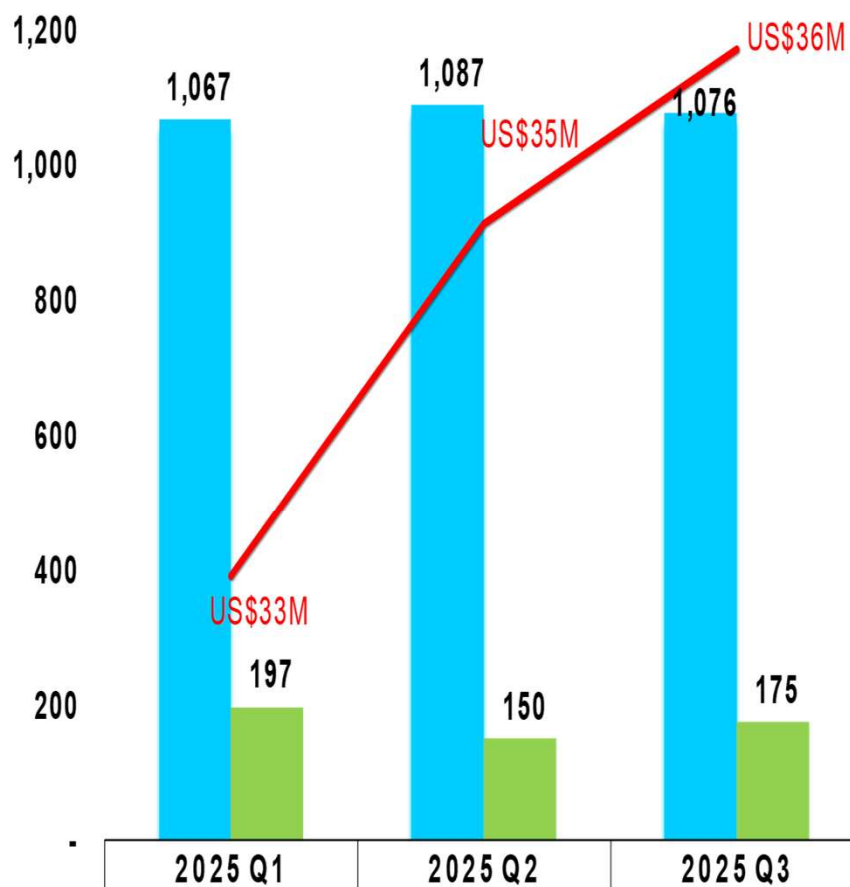
損益表

單位：新台幣百萬元	2024	2025		季變化	年變化	2024	2025	年變化
	Q3	Q2	Q3	QoQ	YoY	Q1~Q3	Q1~Q3	YoY
營業收入	946	1,087	1,076	(1.0%)	13.7%	2,403	3,230	34.4%
營業毛利	173	188	227	20.7%	31.2%	451	654	45.0%
推銷費用	2	3	2	(33.3%)	-	6	7	16.7%
管理費用	19	20	32	60.0%	68.4%	63	76	20.6%
研發費用	11	15	18	20.0%	63.6%	35	49	40.0%
營業費用	32	38	52	36.8%	62.5%	104	132	26.9%
營業淨利(損)	141	150	175	16.7%	24.1%	347	522	50.4%
營業外收支	(3)	(55)	43	-	-	35	3	(91.4%)
稅前、息前、折舊攤銷前獲利	146	101	227	124.8%	55.5%	417	550	31.9%
所得稅	-	-	-	-	-	1	-	(100.0%)
本期淨利	138	95	218	129.5%	58.0%	381	525	37.8%
基本每股盈餘(元)	0.98	0.67	1.54	129.9%	57.1%	2.71	3.73	37.6%

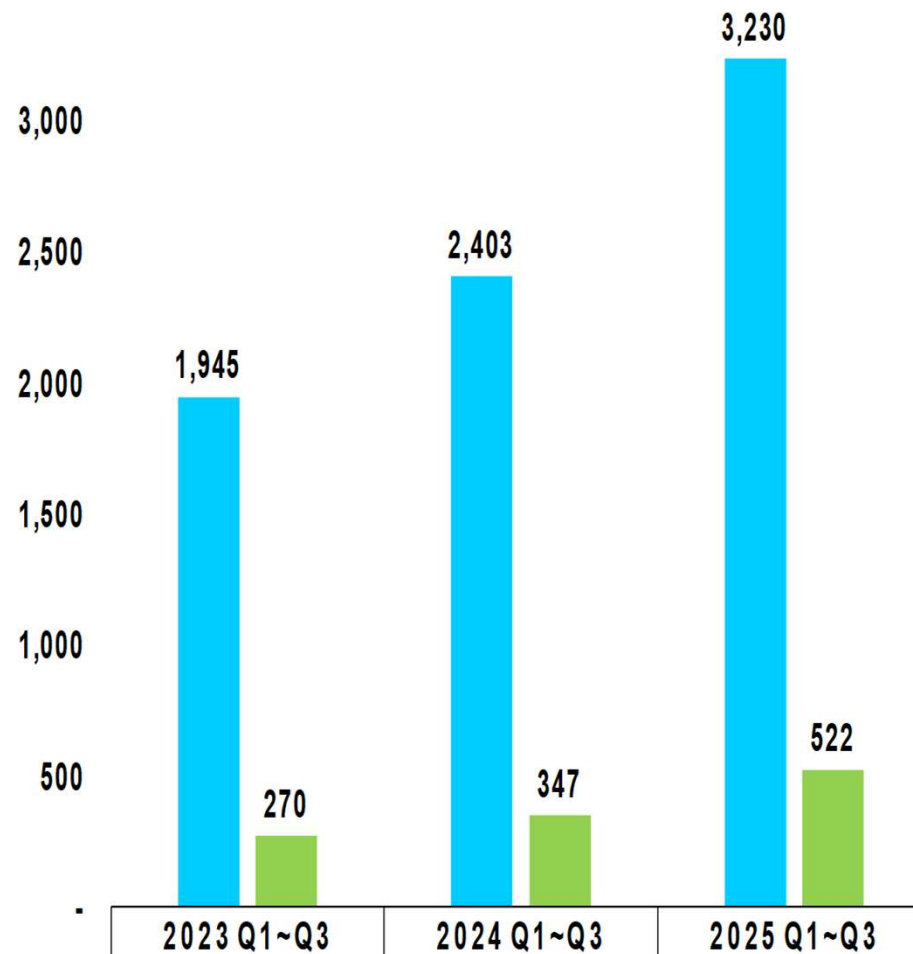
營業收入及淨利-趨勢圖

單位：新台幣百萬元

單位：新台幣百萬元

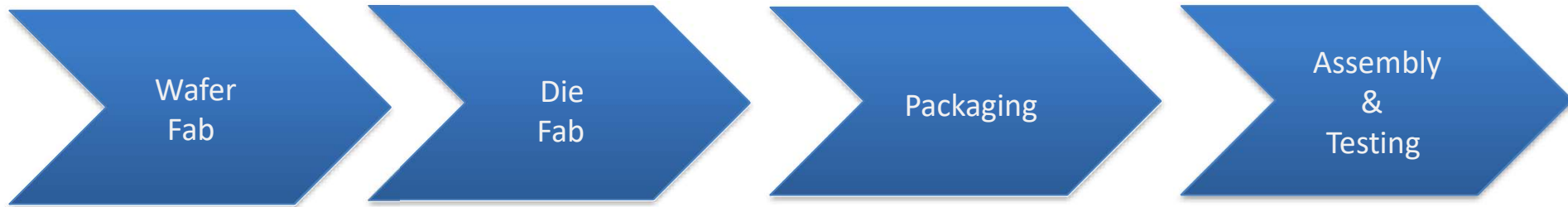


	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
營業收入	1,067	1,087	1,076
營業淨利	197	150	175
營業收入-US\$ M	33	35	36



	2023 Q1~Q3	2024 Q1~Q3	2025 Q1~Q3
營業收入	1,945	2,403	3,230
營業淨利	270	347	522

技術及製程能力



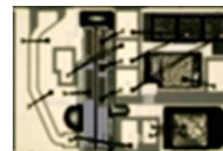
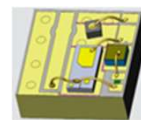
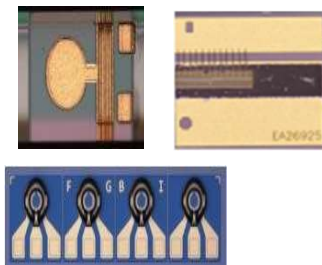
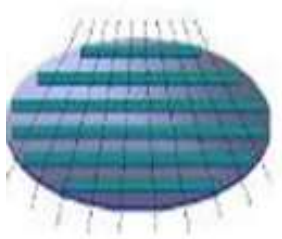
2-4 inches InP_based wafer

- Photolithography(Stepper)
- High quality dielectric thin film deposition(PECVD)
- Dry etching(RIE, ICP)
- Metal deposition and alloy
- Oxygen-free Oven
- Bonder/Debonder combo system
- Wafer lapping/polishing
- Confocal microscopy/ profile meter/SEM

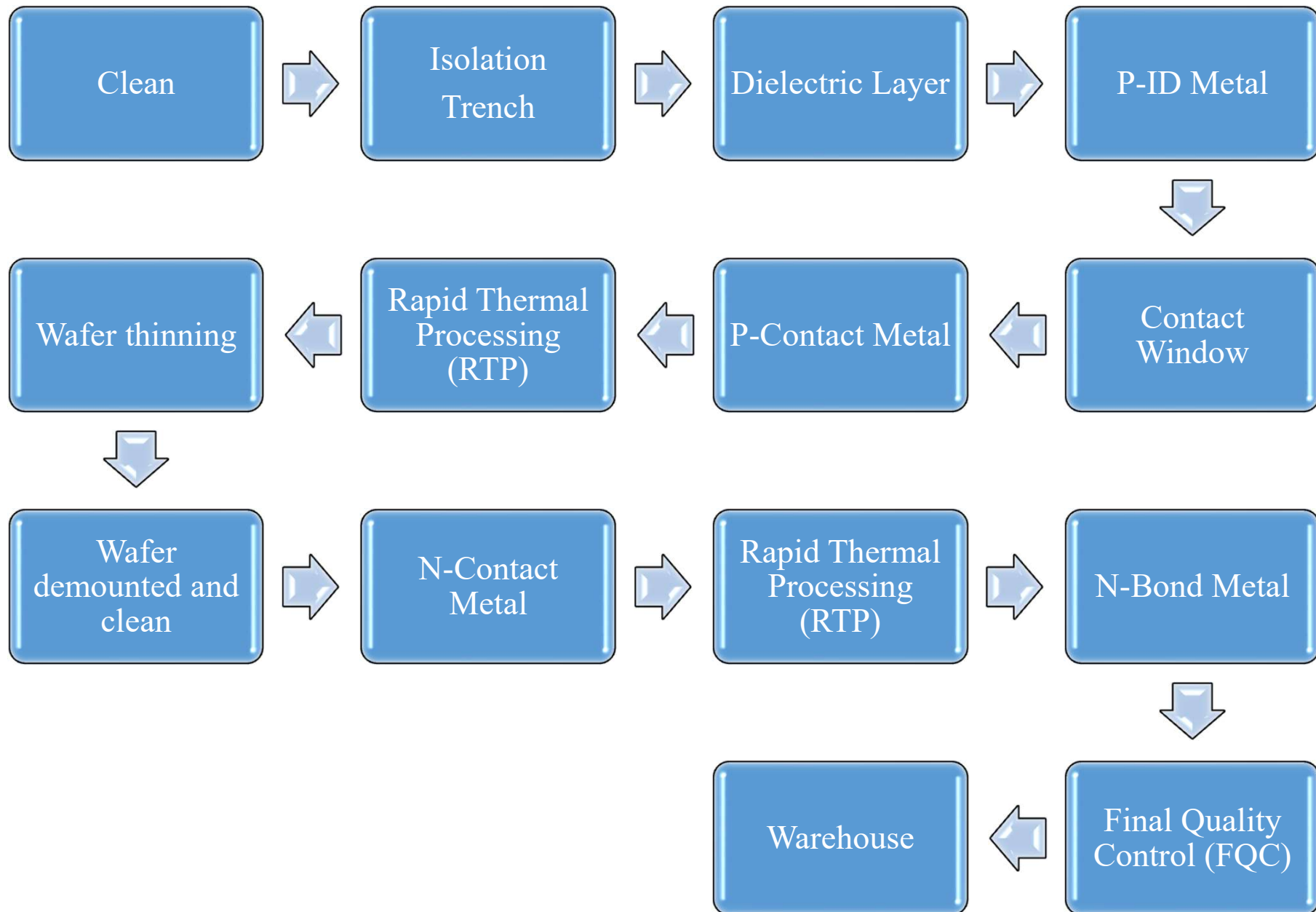
- Scribing and cleaving
- Laser bar stacking
- High quality optical facet coating (ECR, IAD-E beam)
- Chip/bar testing
- Chip mapping sorter
- OCR machine (Optical Character Recognition)
- AOI visual inspection

- Chip-on-carrier
- Chip-on-PCB
- To-CAN packaging
- Box/Butterfly packaging
- Feature process
 - laser assisted bonding
 - high-precision placement (<3um)
 - Flip-chip bonding
 - Fiber Array Attachment
 - Lens Array Attachment

- Optical assembly
- Mechanical/Electrical integration
- Verification and testing
- O/E Characterization
- Data link test
- Reliability test

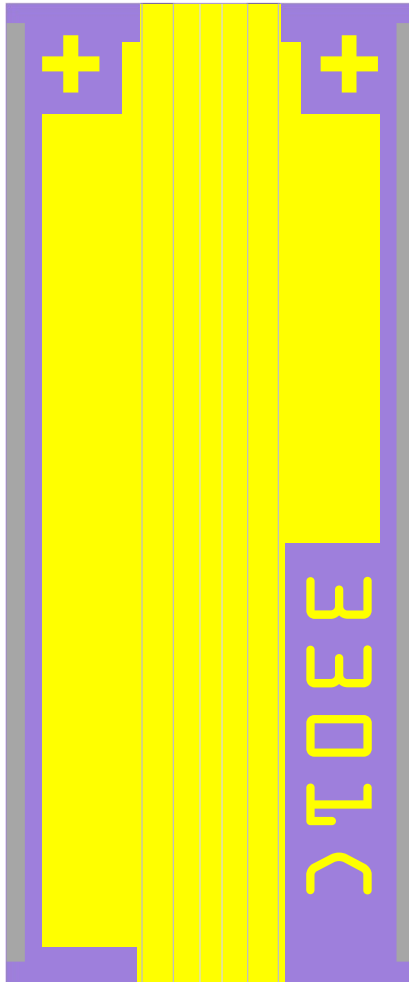


Process flow - wafer process

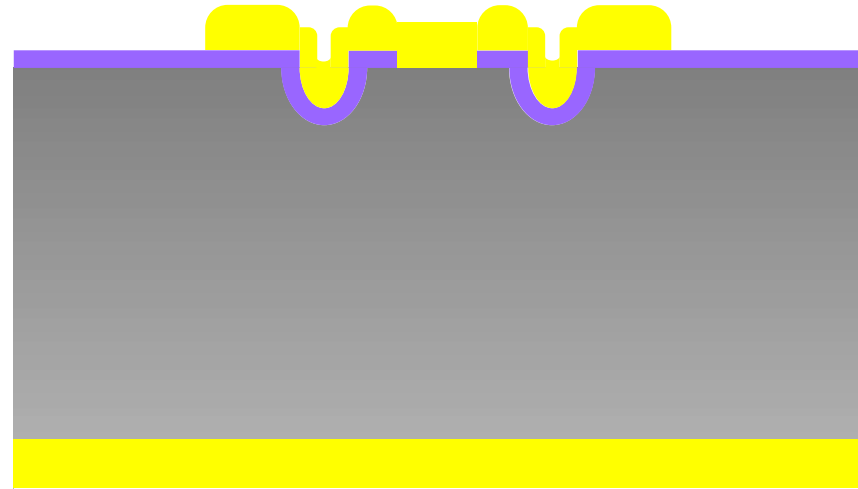


Schematic of wafer process

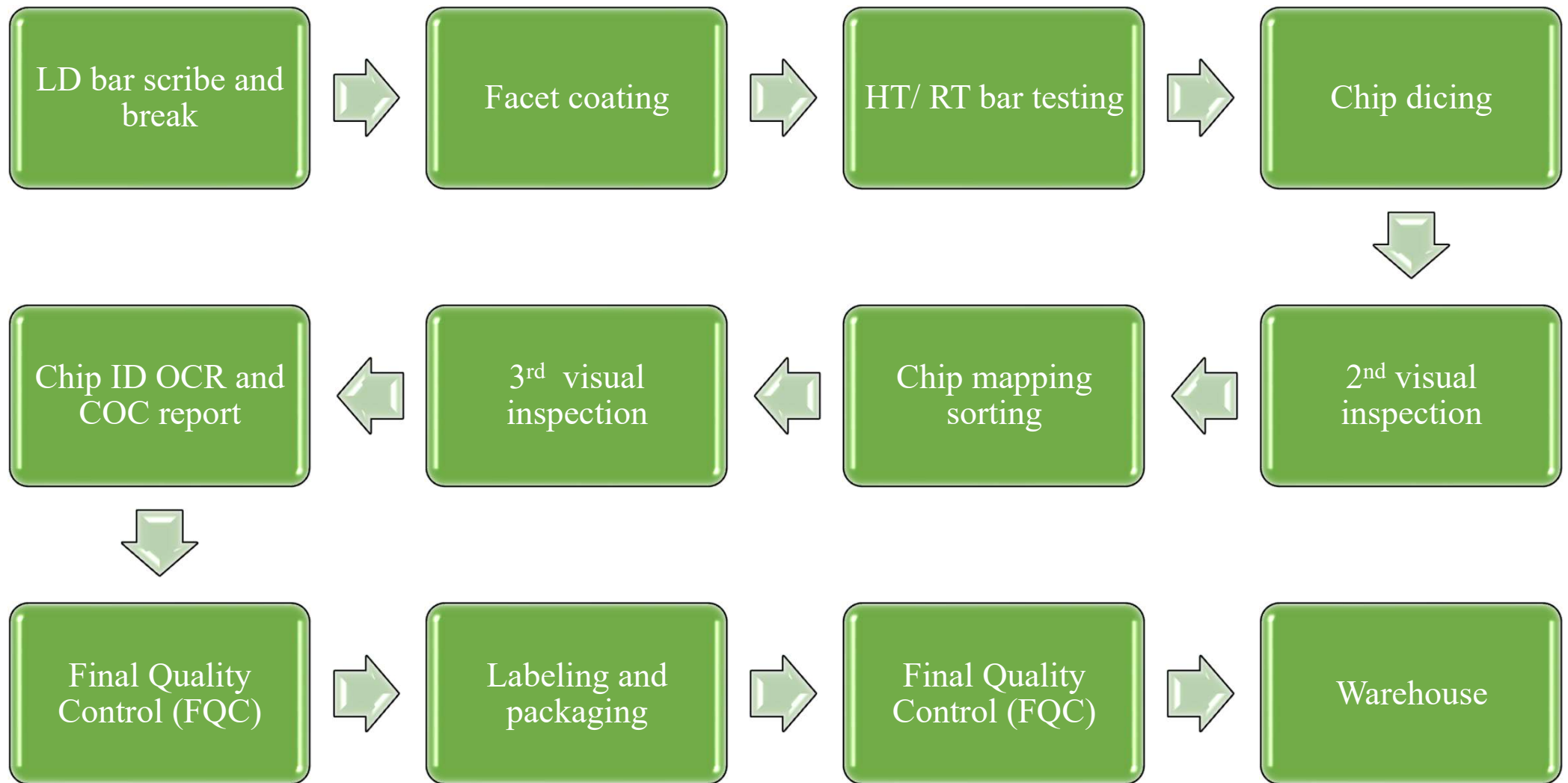
Top view



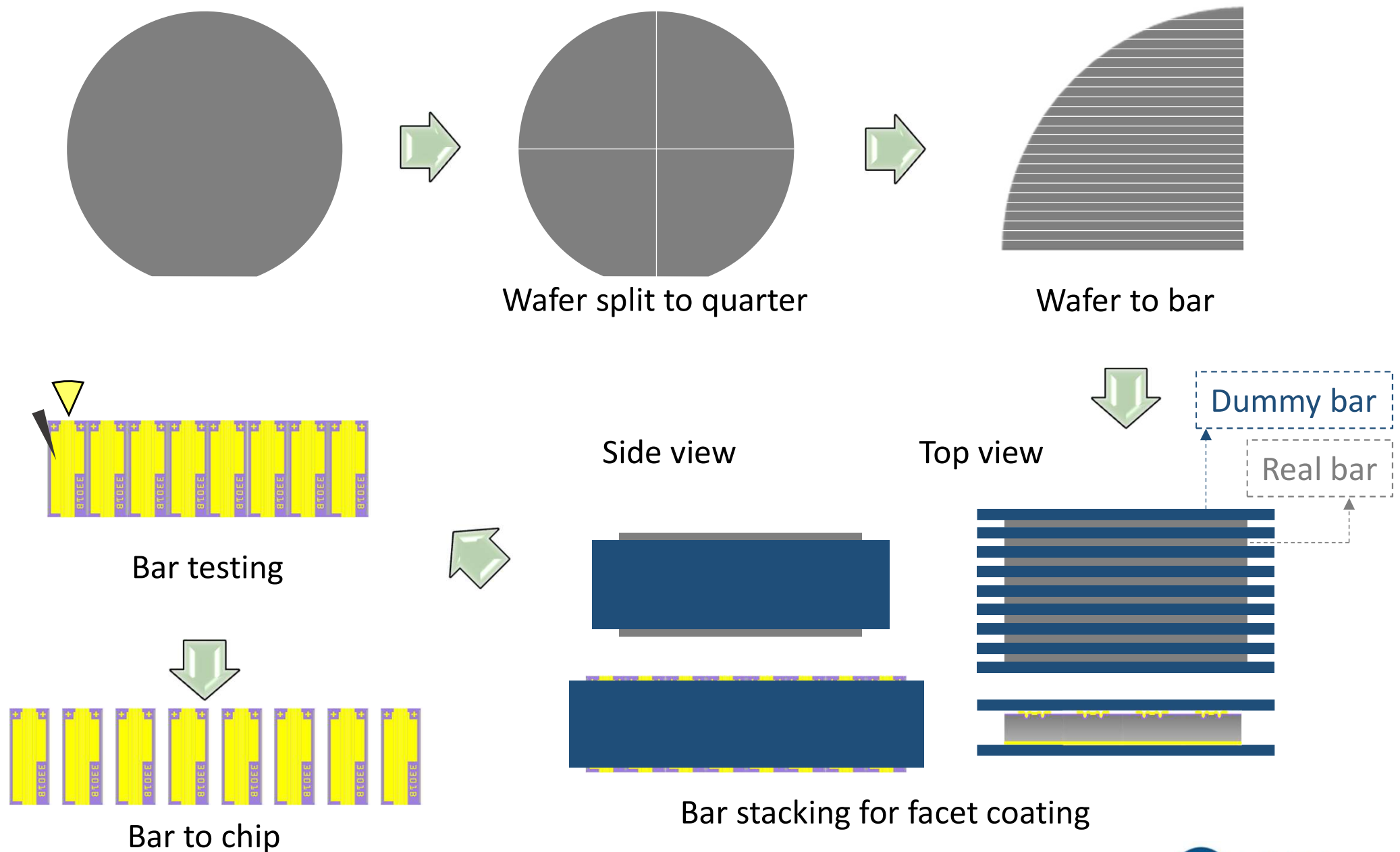
Side view (from AR/HR)



Process flow - chip process



Schematic of chip process



技術及製程能力 - 無塵室



吉林廠 :1600 m² (2025.Q3)

合江廠:

4F

**Transceiver
Line (CM)**



1000m²
(2025.Q1)

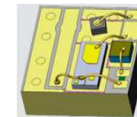
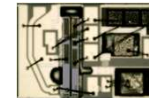
3F



1400m²

2F

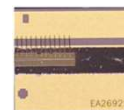
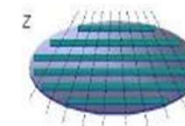
**OSA ,
Optical Engine,
ELS, CoC**



1400m²

1F

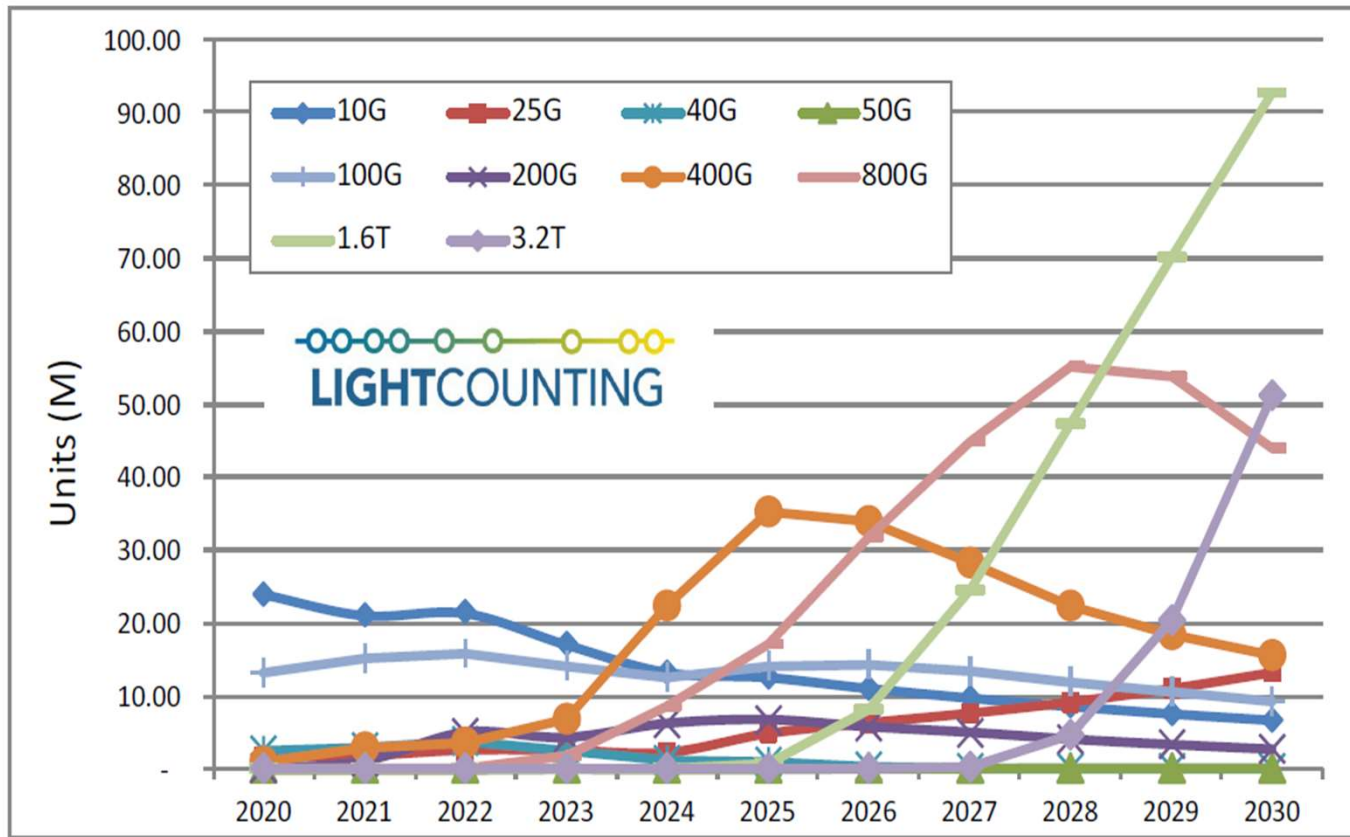
InP FAB



1200m²

市場趨勢及未來展望 – Intra-Datacenter Module

Shipments of Ethernet optical transceivers by Data Rate



Source: LightCounting (2025.09)

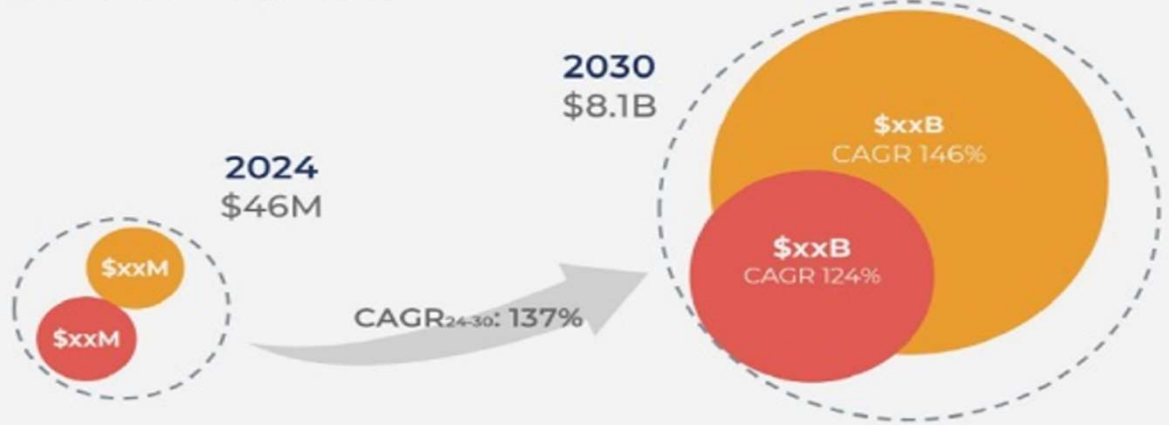
- 由於AI伺服器的大量需求，連帶著Intra-Datacenter的光收發模組也一併需求提升。
- 今年(Y2025)是400G為主，明年則是800G為出貨主力，整年度市場上有 35KK 只的需求。
- 1.6T也預計在明年開始上量，整年度市場需求為 8KK 只。

市場趨勢及未來展望 – CPO

2024-2030 datacom CPO revenue growth forecast by application

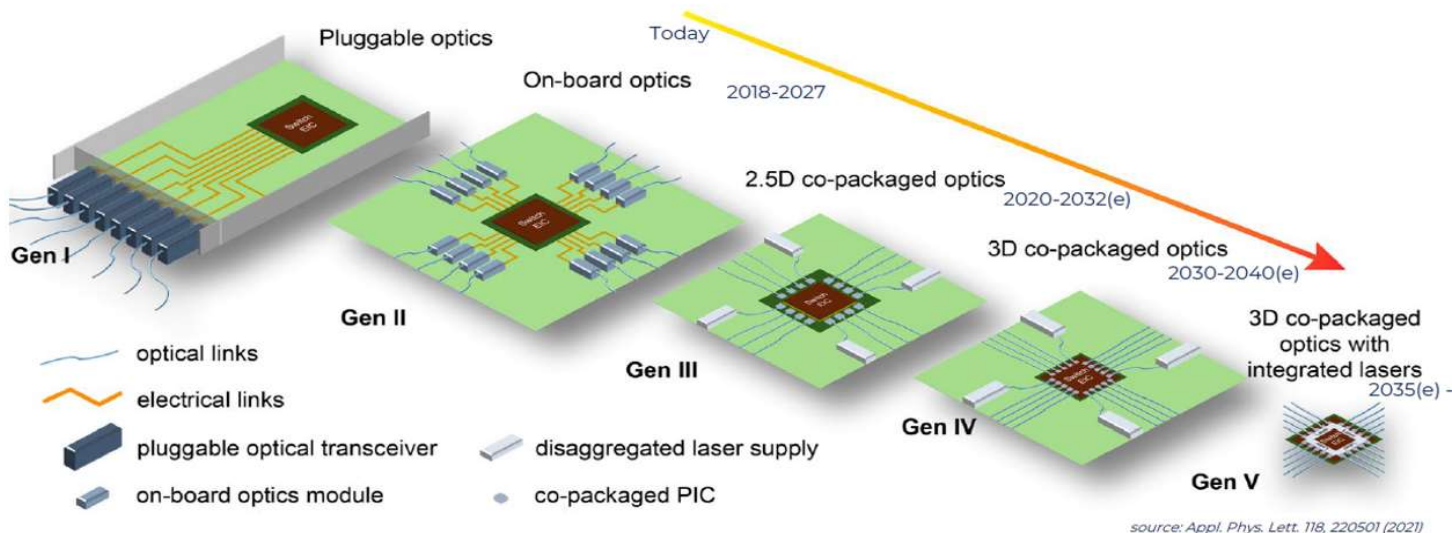
(Source: Co-Packaged Optics for Data Centers 2025, Yole Group, June 2025)

- CPO for Scale-Up Networks
- CPO for Scale-Out Networks (Scenario 1)



Source: Yole 2025.06

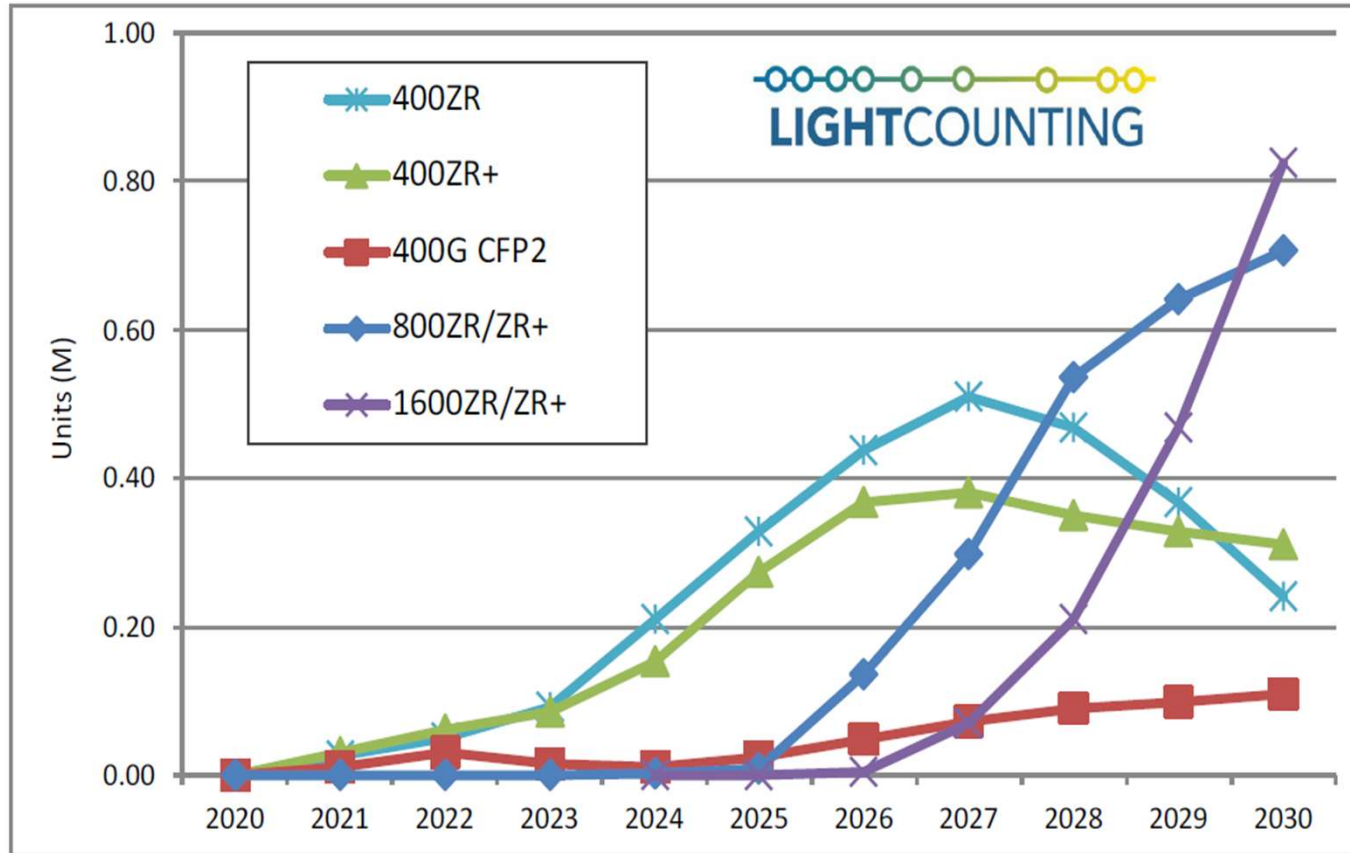
- 去年(Y2024)對於矽光子共封裝光學(CPO)的技術跟需求還處於小量、試量產的研發階段。
- 但今年在NVIDIA的CPO技術正推動AI資料中心變革，預計CPO市場規模將從2024年的\$46M飆升至2030年的\$8.1B，CAGR高達137%，這增長的速度較去年來的更快更急。



source: Appl. Phys. Lett. 118, 220501 (2021)

市場趨勢及未來展望 – Inter-Datacenter Module

Shipments of selected pluggable DWDM modules



Source: LightCounting (2025.09)

- 根據調研機構的預估，明年(Y2026) 400G ZR/ZR+ 會較今年成長約 20%，800G ZR/ZR+ 則是在明年開始量產出貨，27、28年開始倍數成長。

400G ZR/ZR+: 2025 ~ 600K.
2026 ~ 800K.
2027 ~ 900K.
800G ZR/ZR+ 2026 ~ 150K.
2027 ~ 300K.
2028 ~ 550K.

400G/800G/1600G
ZR/ZR+ : 2026 ~ 950K
2027 ~ 1300K
2028 ~ 1600K
2029 ~ 1800K
2030 ~ 2100K

Quarterly and Annual Optical Components Unit Shipments Highlights

OPTICAL COMPONENTS

MODULE SHIPMENTS LEADERBOARD - 2Q25

Rank	 400GbE	 800GbE	 Coherent 400G+
1			
2			
3			
4			
5			

Q & A

THANK YOU

投資人關係窗口：王雅瑜

電話：**886-3-4525188** 分機**2001**

E-Mail：Kelly.Wang@luxnetcorp.com.tw